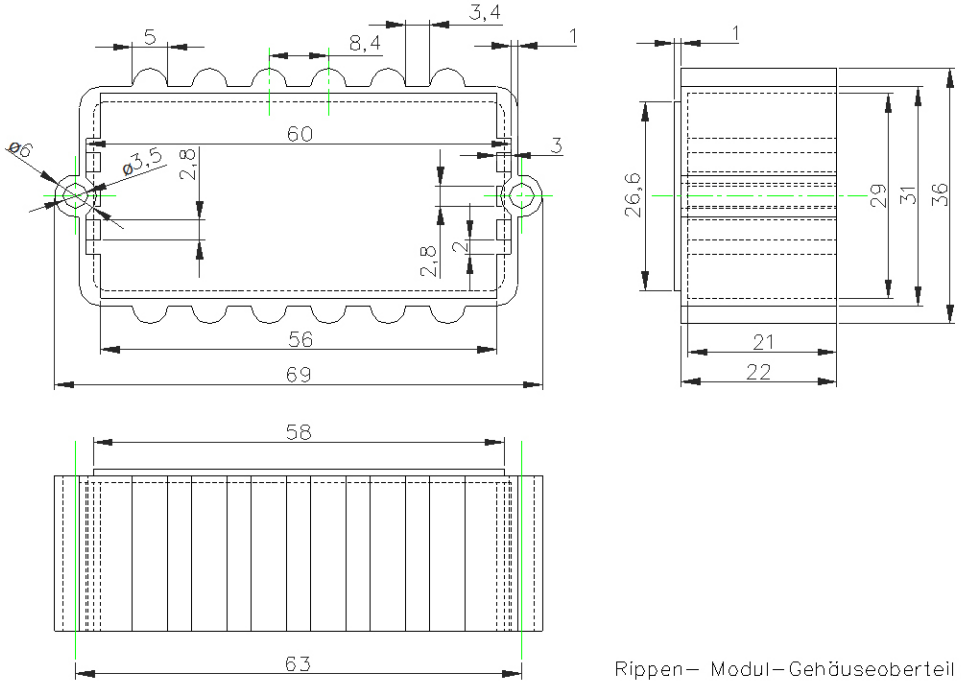
Rippen– Modul–Gehäuseoberteil



Rippen– Modul–Gehäuseoberteil schwarz mit offenem Boden.
Platinen können in die 4 senkrechten Schlitze von 2 mm
Breite links und rechts im Gehäuse, eingesteckt werden.

Gehäuse wird nach Einsetzen und Anschliessen
der Platinen mit Giessharz verschlossen.

|Verwendungsbereich| G006 Modul-Gehäuse mit Befestigungslaschen				|Zul Abw |		|Oberfl |	Maßstab 1:1,5	|Gewicht|
							|Werkstoff, Halbzeug| |Rohteil-Nr| |Modell- oder Gesenk-Nr|	Thermoplast	
					Datum	Name	RIPPEN-MODULGEHÄUSE		
				Bearb.	26 04 05	M SIMON			
				Gepr.					
				Norm					
							G006		Blatt 1 von 1
									Blätter
Zust	Änderung	Datum	Name	KEMO-Electronic GmbH			Ersatz für:	Ersatz durch:	